



SCIENTECH

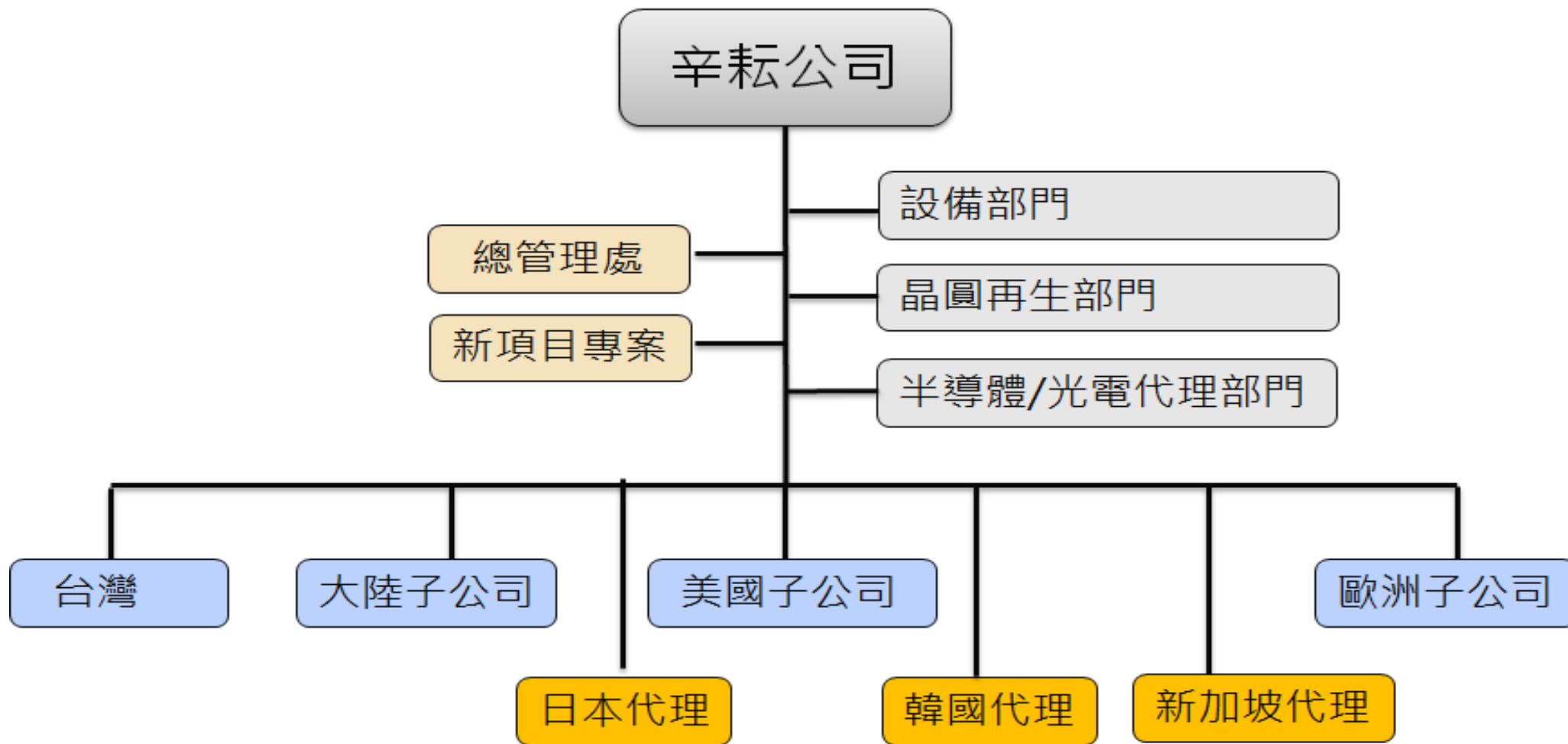
辛耘(3583)

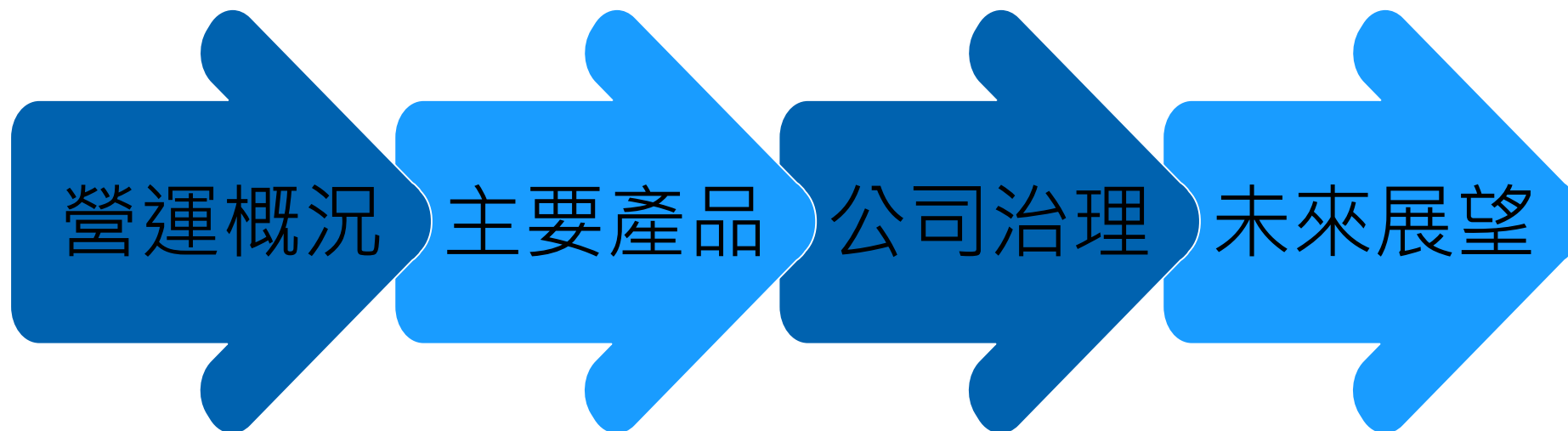
許明棋 2024/09/24

- 本簡報可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期，但同時又受限於已知或未知的風險與不確定性的影響。因此實際結果將可能不同於表述內容。
- 除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對未來展望的表述。

成立時間	1979/10/17
董事長	謝宏亮
執行長	許明棋
資本額	8.03億元
營收(2023)	69.11億元(集團合併)
員工人數	875人 (集團合併)
據點	台北、湖口、新竹、台南、高雄、大陸(上海等17個城市)、香港、美國、歐洲(奧地利) 日本、新加坡、韓國
主要業務	自製設備、晶圓再生、設備代理

辛耘公司組織架構





營運概況

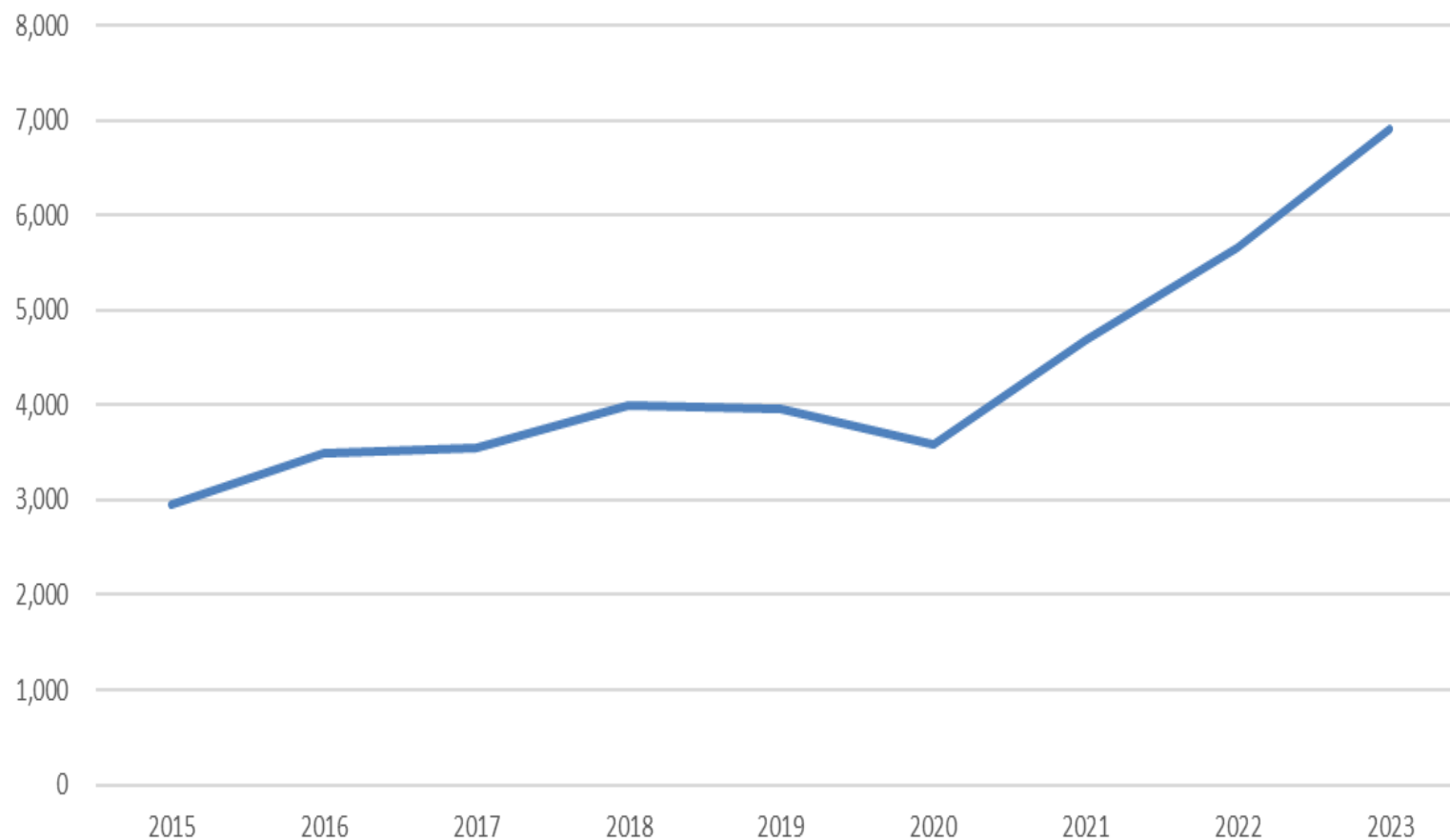


簡明損益表

單位：M	2020	2021	2022	2023	2024/H1
營業收入	3,580	4,684	5,650	6,911	4,617
營業毛利	1,456	1,667	2,084	2,201	1,274
營業費用	991	1,112	1,374	1,483	807
營業淨利	465	555	710	718	466
稅前淨利	389	524	736	860	551
本期淨利	305	420	568	650	436
<u>EPS(元)</u>	<u>3.80</u>	<u>5.23</u>	<u>7.08</u>	<u>8.10</u>	<u>5.43</u>
毛利率	41%	36%	37%	32%	28%
營業淨利率	13%	12%	13%	10%	10%
稅前淨利率	11%	11%	13%	12%	12%

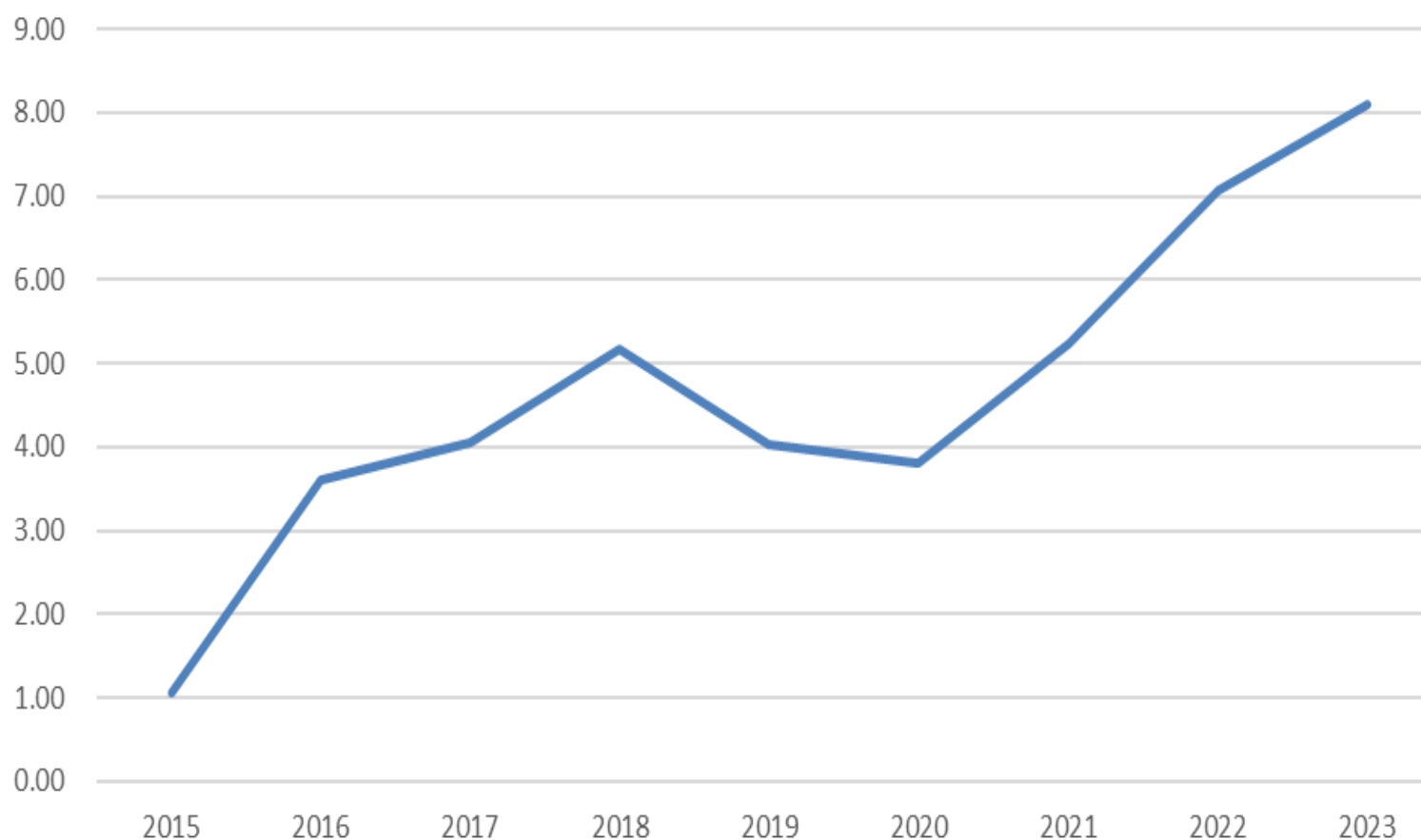
歷年營收

單位： M	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024/ H1
營業 收入	2,942	3,495	3,539	3,988	3,949	3,580	4,684	5,650	6,911	4,617

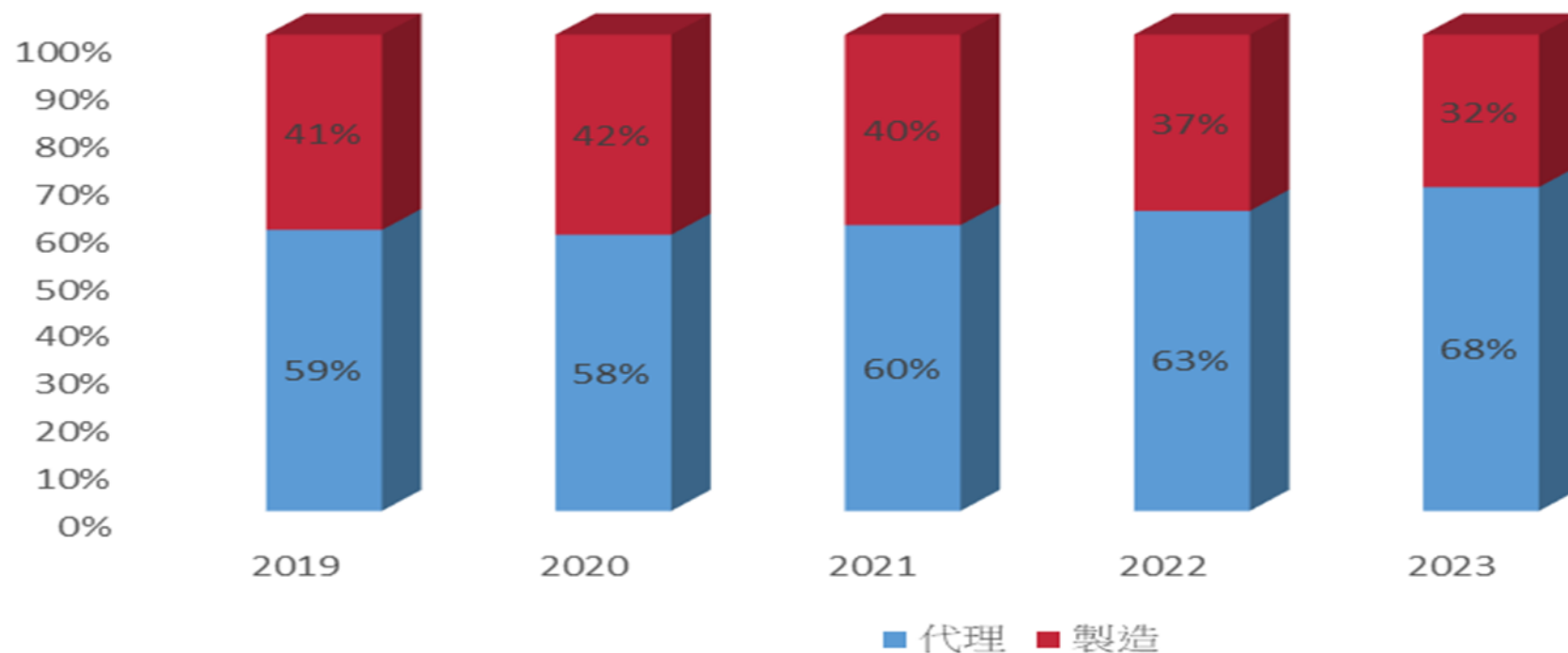


歷年EPS

單位： 元	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024/ H1
EPS	1.06	3.60	4.05	5.16	4.02	3.8	5.23	7.08	8.10	5.43

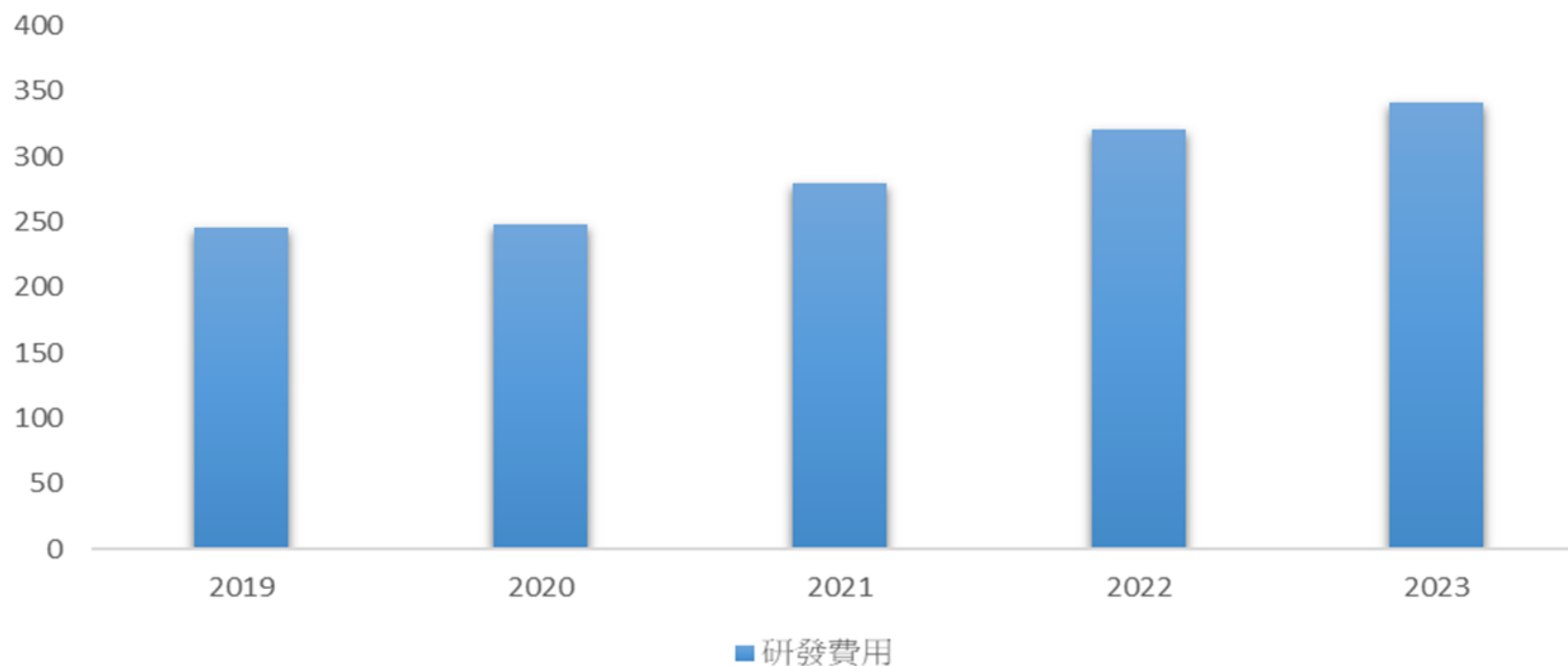


單位：%	2019	2020	2021	2022	2023	2024/H1	毛利率
代理	59	58	60	63	68	65	低於平均
製造	41	42	40	37	32	35	高於平均



研發費用

單位：百萬	2019	2020	2021	2022	2023	2024/H1
研發費用	246	248	280	320	341	181
研發費用佔 營業收入比重	6.2%	6.9%	6.0%	5.7%	4.9%	3.9%
研發費用佔 製造比重	15.2%	16.5%	14.9%	15.3%	15.7%	11.2%



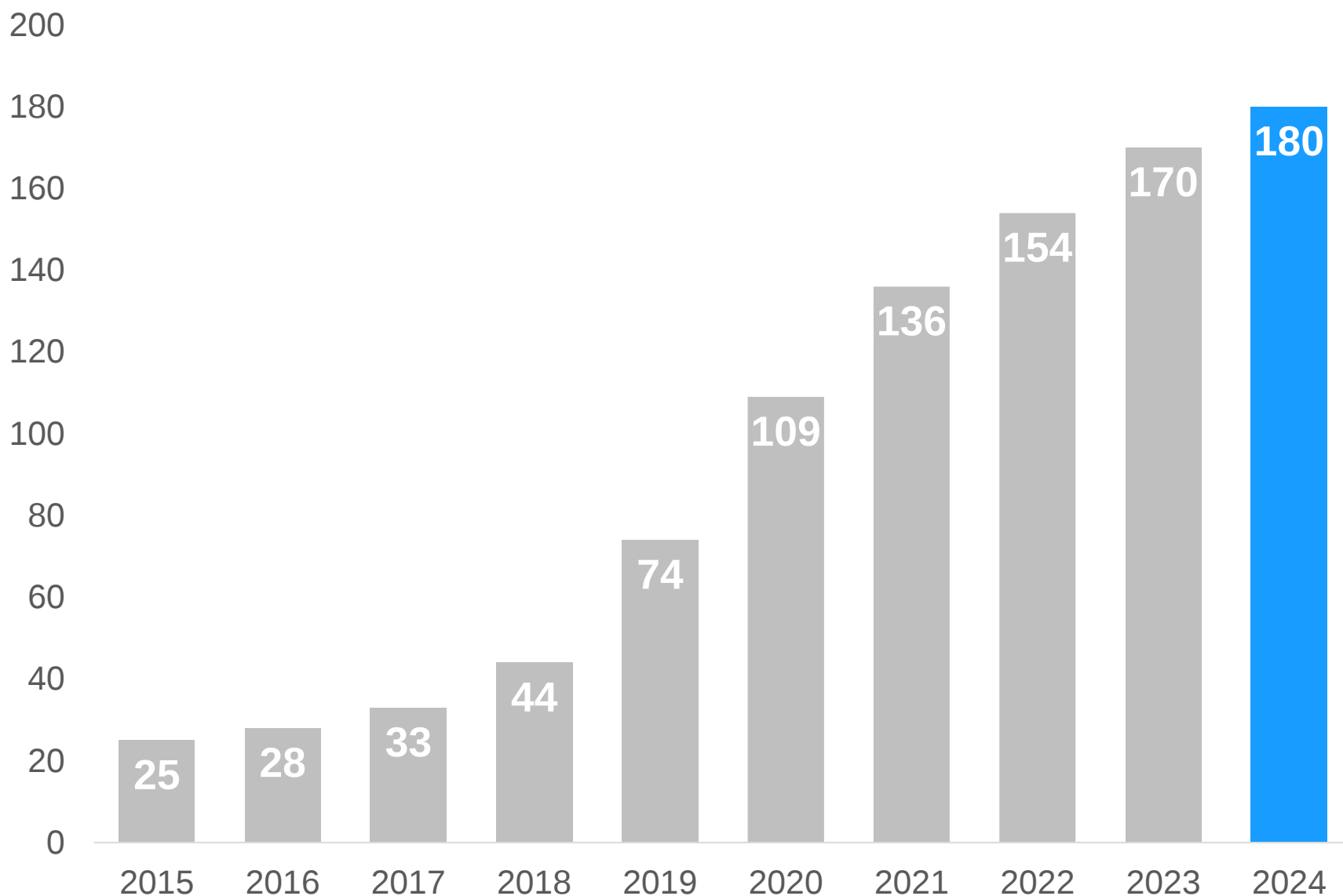
研發專利累積數

- 在案專利累積數

- 180件

- 申請中

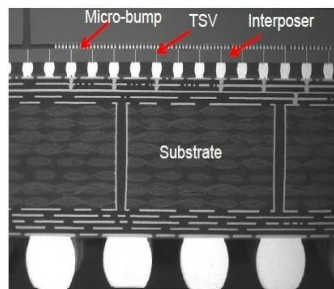
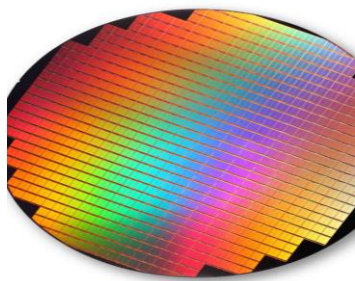
- 50件



主要產品



- 我們服務的產業：
 - 半導體 (前段/先進封裝)
 - 化合物半導體
 - LED / Mini LED / Micro LED
 - 平面顯示器
 - 生物科技/分析儀器



- 半導體
- 化合物半導體
- LED
- 平面顯示器
- 生物科技/分析儀器

設備生產

- 濕式製程設備
- 暫時性貼合及剝離設備
- 半導體/化合物 / LED

代理事業

晶圓再生

- 12" Si (矽) Wafer
- 6" SiC (碳化矽)

Advanced Clean Technology

- 19nm Particle
- Low Trace Metal (<1E9)



Cleaning

Advanced Defect Inspection (SP1/SP2/SP5)

Etching

12" Si Wafer

- Capacity: 160K / Month
- Cu and Non-Cu Process



Full Process Optimization

6" SiC Wafer

- Grinding, Polishing and Reclaim Service
- Capacity: 1K / Month



Polishing

Grinding

Complete Polishing Process

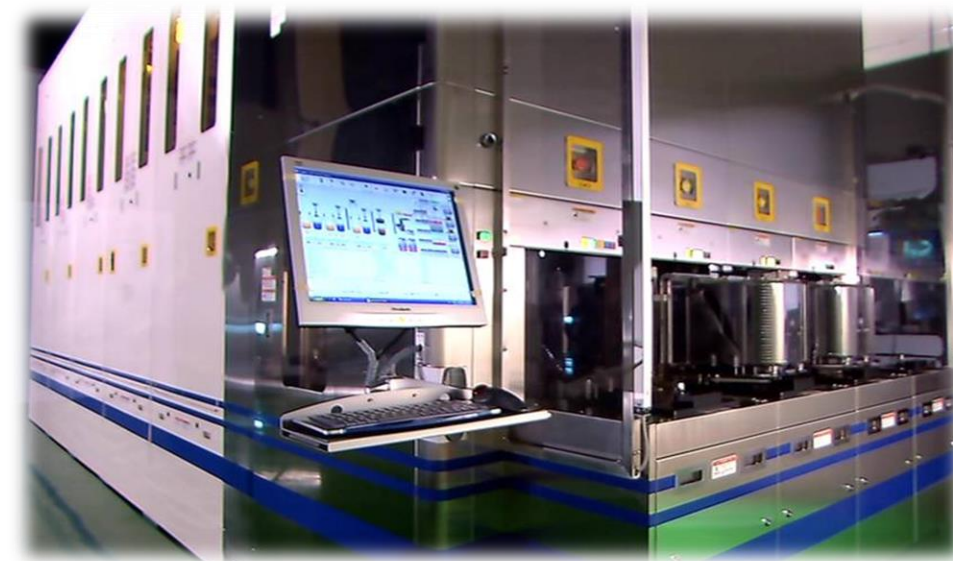
- Single/Double Side Polish
- Final Haze Polish



Super Flatness (GBIR < 0.5mm)

濕式製程設備

- 批次式及單晶圓濕式製程設備
- 應用：
 - 半導體先進封裝製程
 - 半導體前段製程
 - 化合物半導體製程
 - 微機電製程
 - LED/Mini-LED/Micro-LED製程

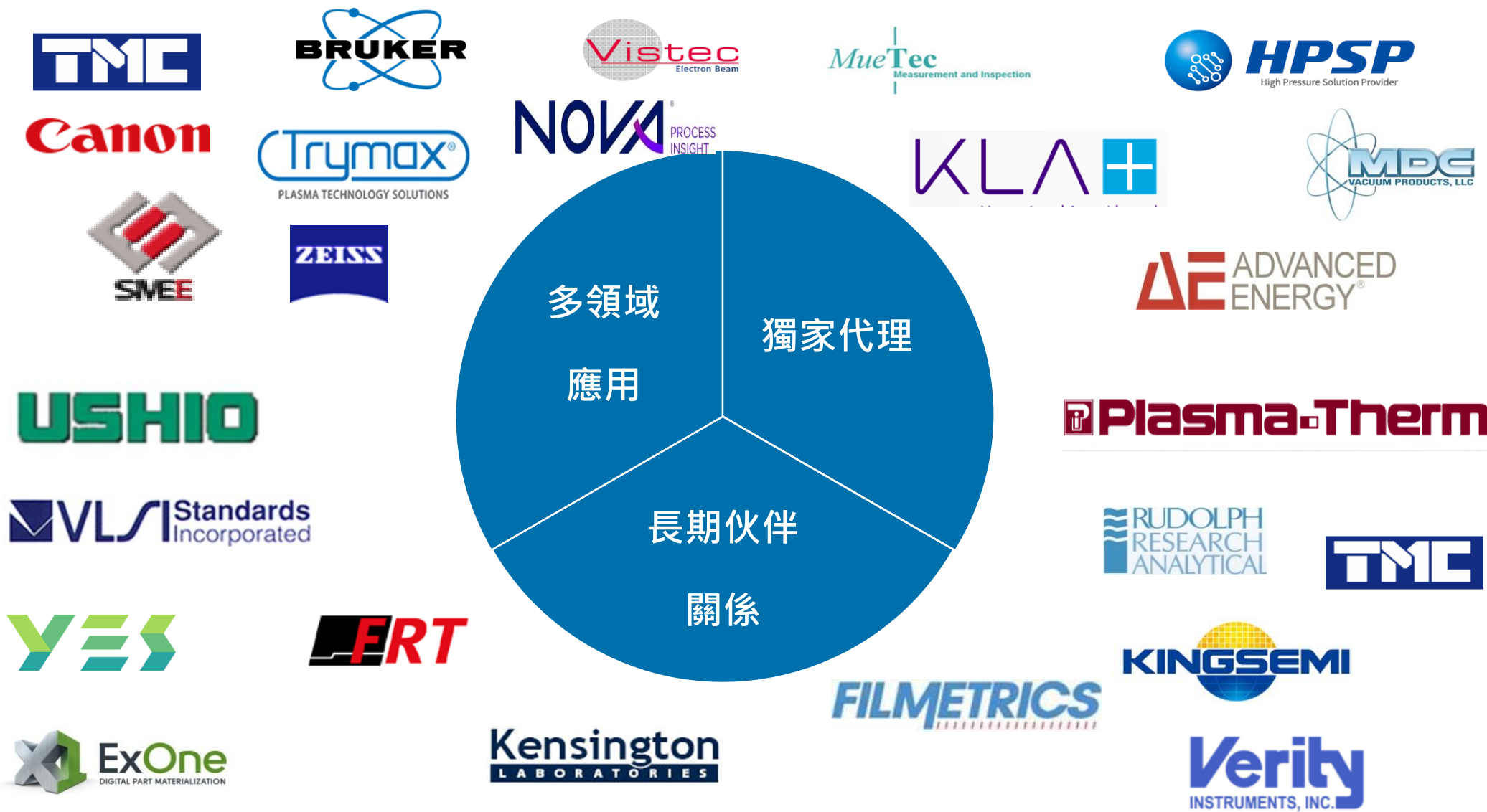


暫時性貼合及剝離

- 暫時性貼合及剝離設備(TBDB)
- 應用: IGBT功率器件,半導體先進封裝
 - 暫時性貼合設備
 - 暫時性剝離設備
 - 解離層塗佈設備
 - 承載盤清洗設備



設備代理



公司治理



公司治理

遵循國際標準，建立管理制度



ISO 9001
品質

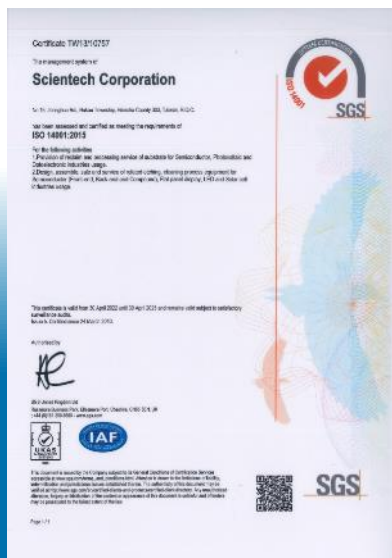
ISO 14001
環境

ISO 45001
職業安全衛生

TIPS
智慧財產

ISO 27001
資訊安全

ISO 22301
營運持續



• TIPS-AA級驗證



Taiwan Intellectual Property Management System

台灣智慧財產管理規範（TIPS）驗證登錄證書

Certificate of Taiwan Intellectual Property Management System

貴公司所建置之智慧財產管理制度，通過台灣智慧財產管理規範（TIPS）推行體系之驗證，特此證明。相關登錄事項如下：

- 一、公司名稱：平耘企業股份有限公司
- 二、受評部門：全公司
- 三、受評地址：新竹縣港口鄉中華路16號
- 四、證書編號：TIPS-2019-驗證-008
- 五、有效期限：2021/12/31
- 六、管理標的：☒專利 ☒商標 ☐著作權 ☐營業秘密 ☐積體電路佈局
- 排除適用：無
- 七、驗證類別：☒AA級 ☐A級（2016年版）

經濟部工業局
局長 呂正華

Certificate of Compliance

This is to certify that the Intellectual Property Management System of the following organization has been verified and fulfilled the requirements of TIPS.

- 1. Company Name : Scientech Corporation
- 2. Registered Department : All Company
- 3. Registered Address : No. 16, Jhonghua Rd., Hukou Township, Hsinchu County 30352, Taiwan (R.O.C.)
- 4. Number of Registration : TIPS-2019-cert-008
- 5. Date of Expiration : December 31, 2021
- 6. Items : ☒ Patent ☒ Trademark ☐ Copyright ☐ Trade Secret ☐ Integrated Circuit Layout
- Exclusion : None
- 7. Certification Level : ☒ AA ☐ A (2016)

Director General
Industrial Development Bureau, MOEA
Richard Lee

ESG永續發展

永續報告書正式發行 2024/08



E



環境友善

S



溫馨職場



回饋社會

G



公司治理

未來展望



- 2024年半導體重回成長趨勢，**庫存去化**逐漸告終
 - 2023年產值衰退11%，但2024成長率將達10%，2025年則增12.5%
- 12”半導體**先進製程**持續發展
 - 前段：5nm、3nm、2nm、1nm
 - 封裝：先進封裝Fan-Out、2.5D (CoWoS)、3D (SoIC)...等等
- 半導體**AI應用**從資料中心擴散到個人裝置
- **CoWoS**產能急速擴充，因應AI晶片強烈需求
- **中國產能擴張**，成熟製程價格競爭加劇
- 化合物半導體：
 - 手機需求減少，需求觸底回升，**GaAs**產能緩步成長
 - **SiC** 需求增，然建廠趨緩



SCIENTECH

Thank You!

<https://www.scientech.com.tw>